



「バックホウ+α」 で実現する ICT 中層混合処理

ダイナW ミキシング 工法

日時：2024年9月18日(水)～9月20日(金)

会場：東京ビッグサイト

ブース番号：G-49 (東1ホール)

日邦電機 / サン・エンジニア

ダイナWミキシング工法 とは

- ・バックホウ に攪拌アタッチメントを接続するだけで、**中層混合処理** ができます
深度0.5～5.0m : バイプロ・バケット型 (VB)
深度3.0～10.0m : ショート・トレンチャ型 (ST)
- ・ICT管理装置 (マルチGNSS) により、施工状況を3D数値データ管理します
ガイダンス機能等により、**初心者オペが即戦力** になります
リアルタイムログデータが、**ベテランの勘を補助し高品質化** します
施工状況を見える化し、**施工管理者の負担が減少** します



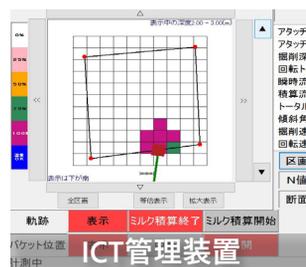
バイプロ・バケット型

(特許取得済)



ショート・トレンチャ型

(特許出願中)



ICT管理装置

